

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年度
持续督导跟踪报告

| | |
|---------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：英集芯 |
| 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：010-56839300 |
| 保荐代表人姓名：付涛 | 联系电话：0755-81902000 |

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对英集芯进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2025 年度，公司不存在违反《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定的情形及需要整改的情况。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代的风险

公司主营业务为电源管理系列芯片、电池管理系列芯片、数模混合 SoC 等相关芯片的研发与销售，主要产品广泛应用于消费类电子领域，最终客户产品更新换代较快，公司需要根据技术发展趋势和最终客户需求不断升级现有产品并持续研发迭代，从而保持市场竞争力。如果公司不能紧跟行业技术的发展趋势，根

据下游客户需求保持较快的技术升级迭代,可能导致公司无法实现技术水平的提升,不能贴紧下游应用的发展方向持续推出具有竞争力的新产品,则公司将因持续创新能力不足而导致市场竞争力下降,给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

2、研发人员流失或不足的风险

集成电路设计企业通常需要长期培养研发设计人员、搭建经验丰富的设计团队,并不断引进优秀的设计人才,且公司的主要产品数模混合 SoC 芯片对设计人员的技术有较高要求。伴随着市场竞争的日趋激烈,行业内公司对于研发人才的竞争不断加剧。如果未来公司出现薪酬水平缺少竞争力、人力资源管理及内部晋升制度得不到有效执行、缺乏有效的股权激励措施等情形,将难以引进更多的优秀技术人才,甚至导致现有骨干技术人员流失,进而对公司技术研发产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

公司核心技术贯穿公司产品研发设计及生产的过程,对公司控制生产成本、改善产品性能和质量至关重要,是公司的核心竞争力。如果出现核心技术保护不利或核心技术人员外流导致关键技术外泄、被盗用、或被竞争对手模仿的情形,则可能对公司的技术创新、业务发展乃至经营业绩产生不利影响。

4、知识产权风险

公司自成立以来一直坚持自主创新的研发策略,已申请多项发明专利、实用新型专利和集成电路布图设计专有权等知识产权来保护自身合法利益,这些知识产权对公司经营起到了重要作用。但考虑到知识产权的特殊性,第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生,而侵权信息较难及时获得,且维权成本较高,可能对公司正常业务经营造成不利影响。同时,也不排除少数竞争对手或第三方与公司及相关人员产生知识产权、技术秘密或商业秘密纠纷,以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素产生非专利技术侵犯第三方知识产权的可能。若上述事项发生,会对公司的正常业务经营产生不利的影

（二）经营风险

国内集成电路设计行业正快速发展，良好的前景吸引了更多新进入企业参与市场竞争，行业原有厂商则在夯实自身竞争优势基础上积极开拓市场，公司所处行业竞争日趋激烈。同时，公司产品主要应用于消费电子领域，技术和产品更新速度快，要求公司能及时、准确地把握市场趋势变化并快速进行技术、产品开发。与同行业龙头企业相比，公司在整体资产规模、产品、技术、市场占有率等方面仍存在一定差距，各方面仍然存在提升空间，如果公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势，优化产品布局，提升技术实力，扩大销售规模，则可能与同行业龙头企业差距加大，进而使得公司的行业地位、市场份额、经营业绩受到不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账风险

报告期末，公司应收账款净额为 15,822.23 万元，占流动资产比例 8.31%，占总资产比例为 6.42%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则会导致该等应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，进而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

2、存货余额较大及减值的风险

报告期末，公司存货账面净额为 59,651.98 万元，占流动资产比例 31.35%，占总资产比例为 24.21%，随着公司经营规模的进一步扩大，存货余额有可能会持续增加，若公司不能保持对存货的有效管理，可能导致存货跌价准备上升，一定程度上会影响公司经营业绩及运营效率。

（四）行业风险

集成电路设计行业与宏观经济、市场需求及技术创新生态关联紧密。若未来宏观经济下行，消费电子、汽车电子等下游行业需求或受冲击，集成电路设计企业订单获取、营收增长将面临压力。同时，行业内消费电子、通信等细分市场投资建设节奏，易受技术迭代速度、创新方向偏差及政策调整等影响，呈现周期性波动。公司既要应对市场需求起伏、竞争加剧，还需持续投入技术创新，一旦创新滞后或方向误判，将在周期波动中面临更大经营不确定性及挑战。

（五）宏观环境风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，有关国家针对半导体设备、材料、技术等相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策，限制中国公司获取半导体行业相关的材料、技术和服务。公司目前存在大量境外采购的情形，公司晶圆的主要供应商如格罗方德、台积电等均为境外厂商，上述出口管制政策可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。虽然公司的采购可选取国内供应商替代生产，但仍需转换成本和磨合周期，因此，一旦由于国际贸易摩擦导致供应商供货受到约束，公司的正常生产经营将受到不利影响。

（六）其他重大风险

上市以来，公司围绕发展战略，通过投资多家企业扩充产品品类、扩大经营规模，旨在构筑更强市场竞争力。但需警惕的是，所投资标的多处于初创阶段，业务模式、技术路径与公司现有体系的协同融合效果尚未完全显现，未来能否形成战略共振、释放协同价值存在不确定性。同时，投资标的在后续经营管理中，将不可避免面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧等外部变量影响，可能引发市场拓展不及预期、经营效率下滑、管理协同不畅等风险。上述因素叠加，导致投资项目的收益实现存在较大不确定性，需持续关注其成长韧性与风险缓释能力。

三、重大违规事项

2025年度，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年度，公司主要财务数据及指标情况如下：

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增 减(%) |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,609,228,659.14 | 1,430,516,298.72 | 12.49 |
| 利润总额 | 169,708,209.27 | 114,812,193.92 | 47.81 |

| 主要会计数据 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增 减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 177,974,383.61 | 124,250,617.15 | 43.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 162,208,181.22 | 110,802,450.40 | 46.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,420,497.61 | 233,896,798.98 | -88.28 |
| | 2025 年末 | 2024 年末 | 本期末比上年同期 末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,193,388,168.55 | 1,987,495,239.87 | 10.36 |
| 总资产 | 2,464,429,632.09 | 2,127,372,885.77 | 15.84 |

注 1：表格中的数据尾差均为数据四舍五入所致。

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增 减(%) |
|-------------------------|--------|--------|------------------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.41 | 0.29 | 41.38 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.41 | 0.29 | 41.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.38 | 0.26 | 46.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.58 | 6.60 | 增加 1.98 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.82 | 5.89 | 增加 1.93 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 19.74 | 21.15 | 减少 1.41 个百分点 |

注：表格中的数据尾差均为数据四舍五入所致。

1、报告期内，公司利润总额同比增长 47.81%，主要系报告期内公司积极开拓新市场与客户资源，持续优化产品成本结构。公司产品在电池管理、PMU、新能源、工业车规等多个领域出货量持续增加，公司营业收入增长、毛利率增加，同时股权激励费用同比下降所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 43.24%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 46.39%，主要系报告期内营业收入增长、股权激励费用同比下降所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 88.28%，主要系报告期内公司根据上游产能情况，增加备货所致。

4、报告期内，基本每股收益（元/股）、稀释每股收益（元/股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）同比增长 41.38%、41.38%和 46.15%，主要系报告期内公司净利润较上年同期增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

2025 年度公司核心竞争力未发生不利变化。报告期内公司继续深耕高性能、高品质电源管理芯片的研发与销售，开展技术研发和产品开发，继续保持原有竞争优势。

（一）研发优势

1、优秀的研发团队

专业人才是集成电路设计企业发展的基础，优质的研发人才对芯片设计企业至关重要。多年来，公司高度重视研发人才的培养与发展，积极引进国内外高端人才，截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 539 人，占公司总人数的 70.46%，其中，具有博士学历 4 人，硕士学历 149 人，具有本科学历 353 人。公司在专注于数模混合芯片的自主研发和技术创新中，已经建立起一支成熟健全、能力突出、经验丰富的科研团队，在电源管理芯片领域较国内竞争者形成了相对明显的技术优势。

同时，公司研发人员年龄主要在 40 岁以下，创新意识强，拥有集成电路行业相关的学历背景和较为丰富的工作经验，保证了公司在技术和产品研发方面相对于同业竞争者拥有优势。公司的核心技术人员共有 5 人，曾供职于国内外知名芯片设计公司，具备扎实的研发能力和丰富的行业经验。由核心技术人员领导并组建的由多名行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

2、较强的系统设计能力

高集成度的数模混合电源管理芯片在设计时通常从性能、功耗和成本三个维度出发。公司基于对模拟电路和数字电路领域的深刻理解，结合强大的自上而下系统架构设计能力，从而设计出来的数模混合 SoC 芯片兼具模拟芯片和数字芯片的优势。相对传统的以模拟电路为主的电源管理芯片比较难实现的性能指标，公司通过对数字电路的处理、修调、校准来实现成本和性能的平衡；对

于传统通过 MCU 算法实现的功能，公司通过设计专用的模拟和数字电路，实现功耗和成本的优化。

（二）产品综合竞争力较强

1、具有高性价比优势，产品可靠性强

公司基于自主研发的数模混合 SoC 集成技术，能够将数字芯片、模拟芯片、系统和嵌入式软件集成到一颗 SoC 芯片中，并同步向客户提供成品开发方案，使得客户成品研发周期缩短、产品生产成本降低、生产过程简化、产品良率和可靠性亦能够得到提升。此外，公司通过先进的系统架构和算法设计，使得开发的芯片在满足客户技术指标要求的同时达到成本优化，保证公司产品的性价比优势。

快充电源适配器的发展趋势是高功率、小体积，随着功率密度的提升，充电器内部的温度可达到 90 度以上，AC-DC 芯片工作时还会产生大量电磁干扰。在这种苛刻的高温高噪声环境中，以快充协议芯片为例，其作为充电器的整体协调接口，必须保证自身长时间、稳定可靠运行。作为少数打入品牌手机客户原装充电器市场的国产芯片厂商，公司的快充协议芯片可靠性高，终端返修的不良率控制在 10PPM 以下。

2、具有高兼容性，支持快充协议类型覆盖面广

目前市场上支持各类快充协议的智能手机、平板、笔记本设备数量庞大，各个设备所支持的快充协议类型、版本各不相同，并且不同的快充协议在逻辑、内容、时序等方面甚至可能相互冲突。要兼容各种快充协议和数量庞大的快充设备，保证快充电源适配器最佳的充电功率，需要有芯片设计和算法软件的紧密配合以及大量的兼容性测试。公司基于自主研发的快充接口协议全集成技术设计的芯片产品，获得了高通、联发科、展讯、华为、三星、OPPO、小米、vivo 等主流平台的协议授权。

3、产品配置多元化，满足客户多样化需求

消费电子领域下游市场终端消费者需求多样，产品需要根据下游需求变化频繁升级。公司设计的数模混合电源管理芯片，在产品定义之初就考虑到客户的多样化需求，预先设计了各种可配置选项。在芯片量产之后，通过在出厂前配置不同的参数代码（例如不同的充放电电压、充放电电流、用户交互方式

等），可快速满足客户新增的各类需求，大大减少了芯片迭代升级的次数，在降低研发费用的同时加速了新产品的面世，便于公司产品快速抢占市场，覆盖客户的更多需求，增加客户粘性。

（三）区位优势，珠三角地区经济活跃，为公司发展带来新机遇

公司所在的珠三角地区经济活跃，为公司发展提供了良好的区域环境。珠三角地区的芯片经销商、终端产品整机厂、最终品牌客户都较为集中，公司充分利用珠三角的区位优势，与深圳当地的经销商、整机厂、最终品牌客户保持紧密沟通。由于公司在地理位置上接近珠三角地区的整机厂、最终品牌客户，公司能够与这些目标客户保持良好的沟通，及时了解行业动态、客户需求，并将市场需求及时准确地结合到公司的芯片产品研发过程中，以客户为中心进行产品的研发，使产品定义、芯片的参数配置能够符合客户多种多样的需求。

消费电子产品更新迭代迅速，与客户在地理位置上的接近也能使得公司及时捕捉到客户的需求变化，为产品的快速迭代创造了有利条件。此外，在后续服务方面，公司也能与整机厂、最终品牌客户保持及时沟通，为其提供有效而及时的技术支持。

（四）客户资源优势

公司产品覆盖电源管理类、电池管理类、数模混合 SoC 类等相关芯片，凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，通过经销为主、直销为辅的商业模式，产品获得了小米、OPPO、vivo、三星、荣耀等知名手机品牌厂商的使用。在汽车电子领域，公司的车规级芯片也进入了十余家国内外汽车厂商供应链。借助积累的优质客户基础，公司进一步提升了品牌认可度和市场影响力，与优质客户的合作带来的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。

六、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2025 年度，公司研发投入为 31,758.99 万元，同比增加 4.95%，主要系报告期加大研发直接投入，扩大研发人员规模。

公司作为技术型企业，研发方向高度重视客户需求和行业技术发展趋势。截至2025年12月31日，公司累计取得国内专利243项，其中发明专利165项，实用新型专利78项。此外公司拥有计算机软件著作权31项，集成电路布图设计专有权273项。2025年度内，公司获得新增授权专利63项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用合计11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。

截止2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,017,660,000.00 |
| 减：发行费用 | 110,264,999.82 |
| 减：银行手续费 | 1321.11 |
| 减：募投项目支出金额 | 318,266,818.38 |
| 减：超募资金永久补充流动资金金额 | 528,820,544.96 |
| 减：补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 36,435,176.13 |
| 加：利息收入 | 36,128,860.40 |
| 募集资金专户余额 | 0.00 |

2025年度，公司募集资金项目投入0.00元、使用超募资金永久补充流动资金78,820,544.96元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金1,017,660,000.00元（抵

扣利息收入后的净使用额），募集资金余额为0.00元。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | 账户状态 |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------|------|
| 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000360384 | 0.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 销户 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755953765610601 | 0.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 211225889370600002 | 0.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 219227798887500003 | 0.00 | 珠海英集芯半导体有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 211227798887500002 | 0.00 | 珠海英集芯半导体有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户） | 226225889370600004 | 0.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户） | 228227798887500003 | 0.00 | 珠海英集芯半导体有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户） | 220227798887500002 | 0.00 | 珠海英集芯半导体有限公司 | 销户 |
| 合 计 | | 0.00 | | |

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）220227798887500002是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211227798887500002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司无控股股东。2025 年度，发行人实际控制人、董事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 黄洪伟 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 4,839,433 | 4,959,433 | 120,000 | 股权激励实施 |
| 陈鑫 | 董事、首席执行官 | 2,632,327 | 2,662,327 | 30,000 | 股权激励实施 |
| 曾令宇 | 董事、核心技术人员 | 1,348,528 | 1,534,528 | 186,000 | 股权激励实施 |
| 敖静涛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 张鸿 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 戴加良 | 副总经理、核心技术人员 | 1,476,818 | 1,494,818 | 18,000 | 股权激励实施 |
| 谢护东 | 副总经理、财务总监 | 63,000 | 90,000 | 27,000 | 股权激励实施 |
| LINGHUI (凌辉) | 首席技术官、核心技术人员 | 63,000 | 90,000 | 27,000 | 股权激励实施 |
| 吴任超 | 董事会秘书 | 245,000 | 350,000 | 105,000 | 股权激励实施 |
| 唐晓 | 核心技术人员 | 996,272 | 1,005,272 | 9,000 | 股权激励实施 |
| 合计 | / | 11,664,378 | 12,186,378 | 522,000 | / |

截至 2025 年 12 月末，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

张鹏

张鹏

付涛

付涛

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2026年5月8日

